

zQSFP+/QSFP28

Interne TE-Nummer 2308171-9

QSFP, QSFP+ & zQSFP+, Cage Assembly with Integrated Connector, 2 x 2, Internal/External EMI Springs, Included Lightpipe, Standard, zQSFP+/QSFP28

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Pluggable IO-Steckverbinder und -Cages > QSFP, QSFP+ und zQSFP+

Steckbarer I/O – Produkttyp: **Cagesatz mit integriertem Steckverbinder**Anschlussmatrixkonfiguration: **2 x 2**Art der EMV-Eindämmung: **Interne/externe EMV-Federn**Integrierter Lichtleiter: **Ja**Verbesserungen: **Standard**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Formfaktor	zQSFP+
Gehäusotyp	Zweireihig
Steckbarer I/O – Produkttyp	Cagesatz mit integriertem Steckverbinder
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anschlussmatrixkonfiguration	2 x 2
Anzahl der Anschlüsse	4
Lichtleiterkonfiguration	Äußere linke Anzeige oben
Anzahl der EONs auf der Rückseite pro Anschlussreihe	0
Anzahl von Positionen	152

Kontaktmerkmale

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	30 µm[.76 µin]
---	----------------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
--	------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktinnenstrom (max.)	.5 A
--------------------------	------

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	2 mm[.079 in]
-------------------------------	---------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
-------------------------------------	-------------------------------

Montage und Anslusstechnik

Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
-------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nickel-Silberlegierung
-----------------	------------------------

Raster	.8 mm[.032 in]
--------	----------------

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	3 mm
--------------------------------	------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Kühlkörperkompatibel	Nein
----------------------	------

Zur Verwendung mit steckbaren I/O-Produkten	QSFP28-Kabelsatz
---	------------------

Steckbare I/O-Anwendungen	QSFP28
---------------------------	--------

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Karton & Einsatz
--------------------	------------------

Weitere

Art der EMV-Eindämmung	Interne/externe EMV-Federn
------------------------	----------------------------

Integrierter Lichtleiter	Ja
--------------------------	----

Verbesserungen	Standard
----------------	----------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und Cl < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **zQSFP+/QSFP28**

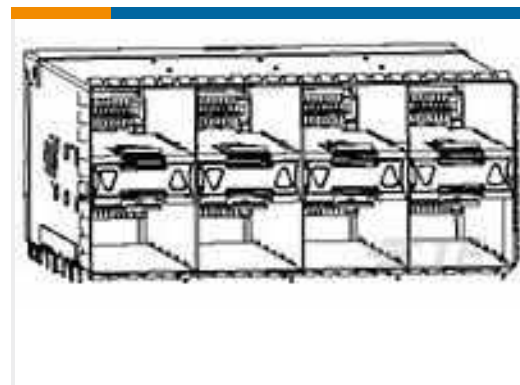
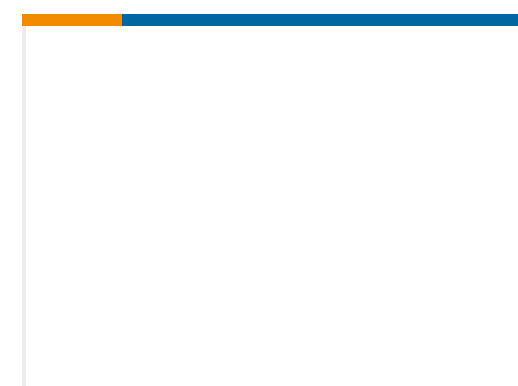


QSFP, QSFP+ und zQSFP+(432)



Steckbare I/O-Kabelsätze(81)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1-1123309-4
DYNAMIC D-5 HDR H ASSY 4P XX AgTE Teilnr.:2180324-8
zSFP+ STACKED 2X4 RECEPTACLE ASSEMBLYTE Teilnr.:1-2333126-2
CAGE ASSY, QSFP28 -DD 1X1, STANDARD, 4LPTE Teilnr.:2-2333126-2
CAGE ASSY, QSFP-DD 1X1, STANDARD, 4LPTE Teilnr.:1775838-6
mini PCI-E 5.6H Type II G/FTE Teilnr.:2016623-5
RF CA, 1.0-2.3 TO UMCC WITH 1.37, L265MMTE Teilnr.:2016623-7
RF CA, 1.0-2.3 BKD TO UMCC GEN1, 1.37 BKTE Teilnr.:2227104-5
1X2 CAGE ASSY, BHND BEZEL, QSFP28TE Teilnr.:2344645-2
zSFP+ STACKED BELLY TO BELLY, 2X4 RECPTTE Teilnr.:2355673-1
CA, INLET TO FLAG FAST

Dokumente

Produktzeichnungen

ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI SPRING, BTB

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2308171-9_A.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2308171-9_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2308171-9_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch